**MSK 双组份有机灌封胶 MR6610AB**

**产品描述**

MR6610AB是一种高透明、高强度、性能优异的有机硅灌封胶。其在固化前具有较低的粘度，两个组分混合后可以在室温下固化，升温可以加速固化，固化时材料无收缩。该产品通过对电子元件进行灌封，固化后具有极低的应力和弹性保护，可有效的防止水分、尘埃及有害气体对电子元器件的侵入，减缓振动，防止外力损伤和稳定元器件参数，将外界的不良影响降到最低。

**产品典型性能参数:**

**产品特点和优点**

* 流动性好
* 透明度＞95%
* 耐黄变
* 线收缩率低
* 100%固体，无固化副产物
* 使用温度-50℃~200℃

**应用**

* 光学器件灌封
* TGBT 灌封
* 精密电子产品灌封

**应用方法**

使用时将 A，B 按照 1：1 的比例混合均匀，将混合后的胶料进行真空脱泡，然后浇注在需要灌封的部位。为达到更好的灌封效果，灌封到产品器件后，可再次真空脱膜。灌封完成后，根据具体工艺条件室温加热固化均可。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性能 | MR-6610AB | 测试标准 |
| 未固化性能 | | |
| 颜色 | 透明 | 目视 |
| 混合粘度/mPa·s | 1000±200 | ASTM D1084 |
| 操作性能 | | |
| 操作时间/min | 30~40 | —— |
| 表干时间/h@25℃ | 2-3 | —— |
| 固化时间/h@25℃ | 4~6 | —— |
| 固化时间/min@80℃ | 20~30 | —— |
| 固化后性能 | | |
| 硬度/A | 30±5 | ASTM D2240 |
| 比重/g/cm3 | 0.95±0.05 | ASTM D792 |
| 抗拉强度/MPa | >1.0 | ASTM D3528 |
| 介电强度/kV/mm | ≥30 | ASTM D149 |
| 体积电阻率/Ω·cm | ≥1X10 15 | ASTM D257 |

**注意事项**

本产品属于加成型固化硅橡胶，遇到以下物质会影响或阻碍产品的固化： 含有锡（Sn2+）、铅（Pb2+）、汞（Hg2+）等重金属离子的化合物；有机锡以及含有机锡的硅酮胶；含 N、S、P 的有机化合物；某些不饱和碳氢增塑剂等。

**包装规格**

20kg/桶，40kg/组。

**储存**

在 30℃以下密封保存，A、B 组分的有效期为自生产日期后十二个月。